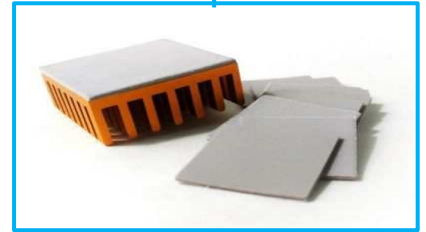


Nos Mousses Thermique appelés aussi Gap Pad ou Gap Filler sont des matériaux thermo conducteurs à base de silicone qui permettent de résoudre les problématiques de dissipation thermique. Le TGF_166_AB est un matelas spécialement développé pour des applications où un besoin de refroidissement intense est demandé. En effet, celui-ci est un excellent conducteur thermique de 16.6 W/mK, avec une très faible résistance thermique facilitant ainsi le transfert de la chaleur et qui a également une excellente isolation électrique. En dessous de 1mm, le matelas est difficilement utilisable en pick-in-place pour de la production robotisée, dans ce cas il faudra prévoir un ajustement de sa dureté avant utilisation. Nous pouvons découper selon plan client.

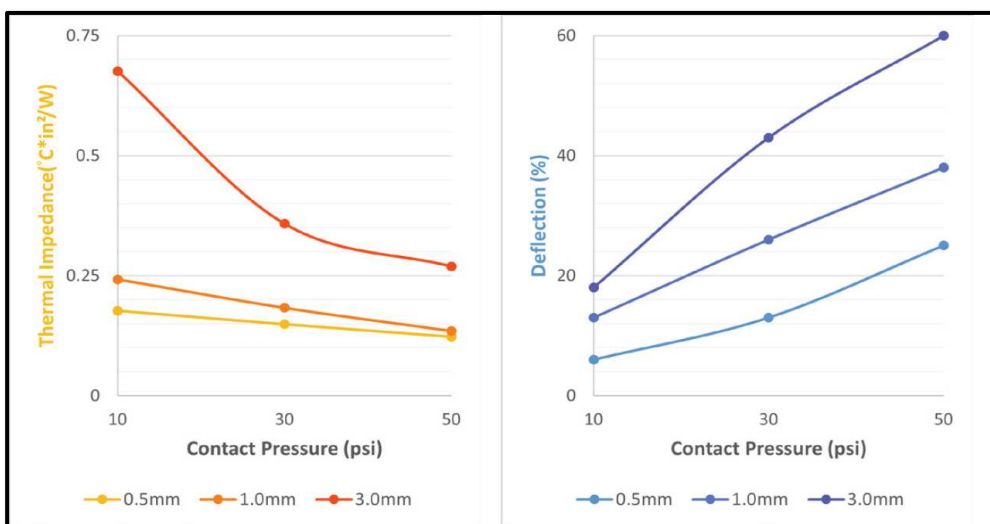


Domaines d'applications: Electronic components - Electric Vehicles, 5G, Autopilot System, Mobile Phone, AIOT, HPC (High Performance Computing), Server, IC, CPU, MOS, LED ,Mother Board, Power Supply, Heat Sink, LCD-TV, Notebook, PC, Telecom Device, Wireless Hub, DDR II Module, etc.

Caractéristiques techniques

Caractéristiques	TGF_166_AB	Unit	Tolerance	Test Method
Couleur	Gris foncé	-	-	Colorimètre CIE 1976
Densité	3.6	g/cm ³	+/- 5%	ASTM D792
Epaisseur	0.5-6	mm	-	ASTM D374
Dureté	65	shore 00	+/- 10%	ASTM D2240
Taille	310*310	mm	-	-
Conductivité Thermique	16.6	W/mK	+/- 10%	ASTM D5470 Modifiée
Perte de poids	< 1	%	-	ASTM E595 Modifiée
Elongation	20	%	-	ASTM D412
Tension de claquage	≥ 7	kV/mm	-	ASTM D149
Résistance volumique	5 x 10 ¹²	Ohm-m	-	ASTM D257
Certification UL	V-0	-	-	UL 94
Température	-50 to 180	°C	-	-

Le TGF_166_AB est disponible de 0.5 à 6mm d'épaisseurs.



Les résultats ont été obtenus en conditions de laboratoire et doivent être considérés uniquement à titre indicatif. AB2E n'ayant aucun contrôle sur le matériel de ses clients et sur de nombreux autres facteurs, il relève de la responsabilité de l'utilisateur d'effectuer ses propres tests pour s'assurer que le produit correspond bien à ses besoins.

